

奇景光電提供台、清、交、成大四校 SLiM™ 整體解決方案 期許產學合作帶動3D感測產業發展

【台南，2018年4月30日】奇景光電（納斯達克代號：HIMX）今（30）日宣布，於2018年4月30日（一）下午，提供奇景 SLiM™ 整體解決方案，給國立台灣大學、清華大學、交通大學及成功大學四校，進行產學協同開發，加速人才培育，期待以產學合作方式，帶動3D感測產業蓬勃發展。

奇景光電於今日下午，由吳炳昌執行長代表出席，提供 SLiM™ 整體解決方案，給代表學校出席的台大李百祺教授兼副院長及簡韶逸教授、清大趙煦教授兼副院長、林澤教授及鍾偉和教授、交大黃乙白教授兼副研發長及郭浩中特聘講座教授，以及成大許渭州特聘教授兼院長及謝明得教授。

奇景光電執行長吳炳昌表示，SLiM™ 整體解決方案，目前已應用在3D感測人臉辨識、擴增實境（AR）、物聯網、醫療及車用等領域，提供給台大、清大、交大及成大四校，希望學界能利用此先進技術，發想改善硬體或是做更多應用。

今天奇景提供 SLiM™ 整體解決方案儀式中，國立台灣大學李百祺教授兼副院長表示，奇景與台大長期以來一直緊密合作，希望能在3D感測技術產學合作上，繼續有良好的成果。清大趙煦教授兼副院長表示，奇景產品技術很先進，學校有很多教授對此新技術很有興趣，除了今天到場的林澤教授及鍾偉和教授外，另外一位翁詠祿教授有事無法出席。交大黃乙白教授兼副研發長表示，感謝奇景提供 SLiM™ 整體解決方案，讓學校能參與新技術開發。成大許渭州特聘教授兼院長表示，奇景一向做很前瞻的技術，不求馬上獲利，研發先進技術的精神讓人敬佩，聽到奇景要提供新技術做產學合作，馬上開心答應。

奇景於2017年8月與高通聯合宣布SLiM™ 整體解決方案（Structured Light Illumination Module），將高通領先業界的3D演算法，與奇景先進的繞射光學設計、近紅外光（NIR，Near Infrared）感測器的尖端設計和製造能力，以及獨特3D感測系統整合技術相結合，提供市場最高端智慧型手機的3D感測需求。

照片由左至右：台大簡韶逸教授、成大謝明得教授、台大李百祺教授兼副院長、奇景吳炳昌執行長、成大許渭州特聘教授兼院長、清大趙煦教授兼副院長、清大鍾偉和教授、清大林澤教授、交大黃乙白教授兼副研發長及交大郭浩中特聘講座教授。

關於奇景光電：

本公司係全球顯示器驅動 IC 與時序控制 IC 領先廠商，產品應用於電視、筆記型電腦、桌上型電腦、手機、平板電腦、數位相機、汽車導航、虛擬實境裝置以及其他多種消費性電子產品。奇景光電的其他產品並包含觸控面板控制 IC、手持式與擴增實境裝置使用的頭戴式矽控液晶光閥（LCOS）微型投影解決方案、汽車使用的抬頭顯示器、LED 驅動 IC、電源管理 IC、監視器及投影機控制晶片、客製化影像處理晶片解決方案及提供矽智權的授權等。奇景光電亦提供數位相機解決方案，包括用於擴增實境裝置、3D 感測及機器視覺的 CMOS 影像感測器及晶圓級光學鏡頭，這些產品已被廣泛地應用在手機、平板電腦、筆記型電腦、電視、網路攝影機、汽車、保全、醫療器材及物聯網等。奇景光電設立於2001年，總部位於台灣台南，目前員工人數約為2,150人，分布於台南、新竹、台北、中國、韓國、日本與美國。至2018年3月31日為止，奇景光電在全球已取得2,999項專利，尚有439項專利正在申請中，產品應用於全球各種消費性電子品牌產品，技術領先並維持影像顯示處理技術半導體解決方案領導廠商的地位。

聯絡人：

黃華珮 / Jessica Huang
公共關係 專案經理
奇景光電股份有限公司
Himax Technologies, Inc.
+886-3-516-3276 分機 38817
jessica_huang@himax.com.tw

林芳妃 / Ophelia Lin
投資人關係 專案副處長
奇景光電股份有限公司
Himax Technologies, Inc.
+886-2-2370-3999 分機 22202
ophelia_lin@himax.com.tw

劉欣杰 / Ken Liu
投資人關係 專案副理
奇景光電股份有限公司
Himax Technologies, Inc.
+886-2-2370-3999 分機 22513
ken_liu@himax.com.tw

Investor Relations - US Representative
Greg Falesnik, Managing Director
MZ North America
Tel: +1-212-301-7130
Email: greg.falesnik@mzgroup.us
www.mzgroup.us

風險說明：

本新聞稿的部分展望未來的陳述，特別是有關於財務、產業預測，可能會導致實際結果與本新聞稿的描述不同，可能造成差異的因素包括但不限於整體市場與經濟的狀況、半導體產業的狀況、市場對本公司驅動 IC 產品及非驅動 IC 產品之接受度、產品競爭力、市場競爭、終端市場需求、對少數主要客戶的依賴度、持續創新的技術、新面板技術發展、發展與維護智慧財產權的能力、價格壓力如平均售價下滑或客戶訂單模式改變、全年有效稅率預估的改變、面板其他關鍵零組件短缺、政策法規改變、匯率波動、子公司新投資案、對客戶應收帳款的回收與存貨的管理、維護及吸引人才，包括本公司為 2017 年度所申報的 20-F 文件中「風險因素」標題項下的該等風險。不論是否有其他新的訊息或事件，本公司皆無義務公開更新或修改此風險說明。